

上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于预计 2024 年度对子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：南京凌鸥创芯电子有限公司（以下简称“凌鸥创芯”），为上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。
- 本次担保金额及已实际提供的担保金额：公司预计 2024 年度为控股子公司凌鸥创芯提供担保总额不超过人民币 5,000 万元，截至本公告披露日，已实际为其提供担保余额为 4,538.70 万元。
- 本次担保无反担保。
- 本次对外担保已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足经营生产及业务发展需要，公司拟为控股子公司凌鸥创芯提供不超过人民币 5,000 万元担保额度，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。董事会授权董事长或其授权人士在上述担保范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由相关业务部门负责组织实施。

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度对子公司提供担保额度的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议，经公司董事会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

- 企业名称：南京凌鸥创芯电子有限公司

2、注册地址及主要办公地点：南京经济技术开发区兴智路 6 号兴智科技园 B 栋第 15 层

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、注册资本：289.5255 万元人民币

5、法定代表人：胡黎强

6、成立日期：2016 年 8 月 16 日

7、经营范围：

许可项目：检验检测服务；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：电子元器件制造；电子产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海晶丰明源半导体股份有限公司	178.3878	61.6138
2	李鹏	44.4835	15.3643
3	钟书鹏	33.0895	11.4289
4	南京道米企业管理合伙企业（有限合伙）	32.3789	11.1834
5	邓廷	0.8932	0.3085
6	张威龙	0.2926	0.1011
合计		289.5255	100.0000

9、主要财务数据

单位：人民币 万元

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额	18,665.38
负债总额	3,312.85
资产净额	15,352.53
营业收入	17,647.89
净利润	5,286.60
扣除非经常性损益后的净利润	4,994.01

审计情况	已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计
-------------	----------------------

10、凌鸥创芯不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响偿债能力的重大或有事项

11、经公司在中国执行信息公开网查询，凌鸥创芯不属于失信被执行人

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司与无锡华润上华科技有限公司签订担保最高债权金额为人民币 1,200 万元的担保合同、与上海华虹宏力半导体制造有限公司签订担保最高债权金额为人民币 3,338.70 万元的担保函，担保对象均为南京凌鸥创芯电子有限公司，担保内容为对凌鸥创芯产生的系列债权进行担保，上述担保余额未超过本次担保预计额度；担保合同所涉及的担保金额、期限、方式等内容均符合法律法规等相关要求。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项系为确保控股子公司生产经营工作持续、稳健开展需要，结合目前公司及控股子公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要。被担保对象为公司合并报表范围内正常、持续经营的控股子公司，经营情况稳定，公司提供担保的风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2024 年度对子公司提供担保额度的议案》。

董事会认为：本次担保事项是为满足公司及子公司未来日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，符合公司的发展规划。公司及子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为 5,000.00 万元（指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，且均为公司为合并报表范围内的全资及控股子公司提供的担保），分别占公司最近一期经审计总资产和净资产的 2.11% 和 3.62%。公司及子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保

的情况。逾期担保累计金额为 0 元，涉及诉讼的担保金额为 0 元。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 18 日